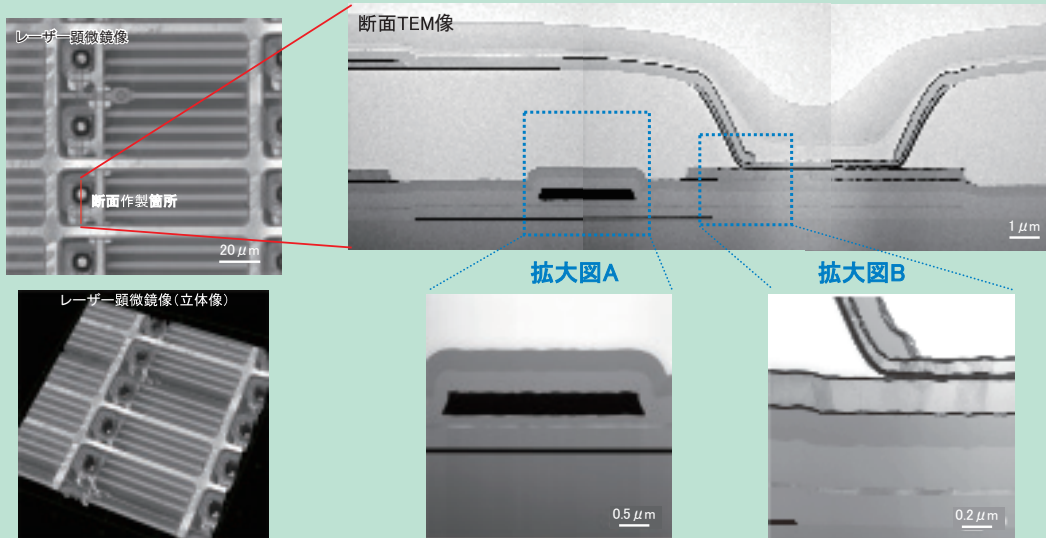


スマートフォンディスプレイ タッチパネル電極の断面観察

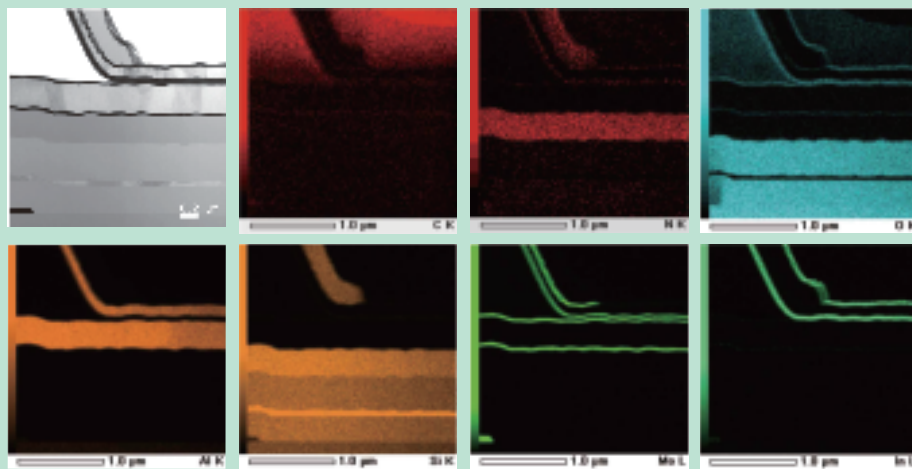
概要

FIB加工により、スマートフォンディスプレイの目的の微小部位について検体を作製し、TEM観察、解析することが可能である。この方法により素子のミクロな構造を観察、元素分析をおこなった例を紹介する。

- 分析サンプル:スマートフォン TFT基板側 ・ FIBにて断面加工し、TEM観察を実施



- 拡大図BのEDS元素分析結果 (イメージング)



この分析法は機種毎の構造比較、各種トラブルの原因解明に有効である

株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎03-5524-3851